, 251

JA 0265702

(54) MICROWAVE CIRCUIT

(11) 1-265702 (A) (43) 23.10.1989 (19) JP

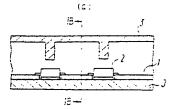
(21) Appl. No. 63-96159 (22) 18.4.1988

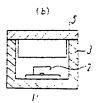
(71) MITSUBISHI ELECTRIC CORP (72) SHUJI NISHIMURA

(51) Int. Cl<sup>4</sup>. H01P3/08,H05K9/00

PURPOSE: To suppress the propagation due to an undesired waveguide mode by providing a shield plate on a semiconductor element in the inside of a case in a direction orthogonal to the signal transmission direction.

CONSTITUTION: The circuit consists of a case 3 and a cover connecting a semiconductor element 2 with a microstrip line 1 and mounting it. The cover 5 mounted with a shield plate is provided on the semiconductor element 2 in a direction orthogonal to the transmission direction. Thus, the propagation of the undesired waveguide mode generated in the case 3 and the cover 5 is suppressed and the prevention of abnormal oscillation due to undesired feedback in, e.g., a high gain multi-stage amplifier and the reduction of interference between input and output are facilitated.





⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-265702

®Ínt. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)10月23日

H 01 P 3/08 H 05 K 9/00

8626-5 J F-7039-5E

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称 マイクロ波回路

②特 願 昭63-96159

**20出 願 昭63(1988)4月18日** 

**@**発明者 西村 修

司 丘庸退尼崎

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社 通信機製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

の代 理 人 弁理士 早瀬 憲一

en an

1. 発明の名称

マイクロ波回路

2. 特許請求の範囲

(1) マイクロストリップ級路に半導体案子を装 着したマイクロ放集機回路を導電体からなり上記 マイクロストリップ級路と長手方向を共通にする ケースおよびその開口部を覆うカバーによつて包 んでなるものにおいて、

上配ケースおよびカバーで包まれる空間内の上配半導体祭子の上部に上配長手方向に直角な方向のシールド板を備えたことを特徴とするマイクロ放回路。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、マイクロストリップ級路と半導体 ステとからなるマイクロ破壊積回路と、ケース及びカバーとで構成されたマイクロ波回路に関するものである。

〔従来の技術〕

第4図(a)は従来のマイクロ皮回路を伝送方向に切断した側面断面図であり、同図(b)は図(a)の NB-NB-棚での平面断面図である。

図において、(1)はマイクロストリップ級略、(2)は半導体素子、(3)はケース、(4)はカバーである。
次に動作について説明する。マイクロストリップ級略(1)と半導体業子(2)とからなるマイクロ波集
種国略をケース(3)及びカバー(4)の中に入れてマイクロ波回略を構成する場合、マイクロストリップ
級路(1)上を伝搬するに号のほかに、ケース(3)及びカバー(4)内が導放管として動作し、不要な導放管モードによる信号が伝搬する。

退放管モードによる伝搬は、第4図(b)中の長さ Bによりカットオフ周波数 5cが式[i] のように決 まり、マイクロ放集機回路の大きさの制約により Bを所要の長さにできなくて所要周波数 5 が 5 c より大きい場合、より一層不要な電波の伝搬が生 じる。

fc = C/2·8 C: 光速 … [1]

### 〔 発明が解決しようとする課題〕

従来のマイクロ破回路は以上のように構成されているので、カバーの内個やケース内に埋放吸収はな取付けて、不要な促放の伝搬を抑えると所要な必必要であり、しかも、この方法によると所要のようとの様の減少等が生じるなどの課題があつた。またことのは多くである。 半導体者子やマイクロストリップ回路の大きさにより、前述のケース内の幅をを所要の幅にできずるなどの課題があった。 様額があつた。

この発明は上配のような課題を解決するためになされたもので、所要倡号を損失なく伝搬し、かつ不要な電波の導放管モードによる伝搬を押えることができ、かつ製作が容易なマイクロ放回路を得ることを目的とする。

# [ 課題を解決するための手段]

この発明に係るマイクロ 放回略は、半導体 数子をマイクロストリップ 線路で接続し、 これらを取付けるケース及びカバーとからなるマイクロ 放回

(3)

シールド板を取付けたカバー(5)を設けたので、ケース(3)及びカバー(5)内で発生する不要な導放管モードの伝搬を押えることができ、例えば、高利得多段増幅器における不要な帰還による異常発振の防止や入出力の干渉の軽減等が容易に可能となる。

また、電波吸収体を用いて不要な電波の伝搬を 抑える方法に比べると、所要信号の損失がなく、 出力電力の減少やNFの劣下、利得の減少等の問題 点はなくなる。

なお、上配第1の実施例ではシールド板とカバーとを一体化したものを示したが、第3図に示す第2の実施例のように、シールド板(6)とカバー(4)とを分離し、ケース(3)に環を切り、その選にシールド板(6)を落とし込む構造にしてもよい。第3図(a)はこの第2の実施例の信号伝送方向に切断した個面断面図、同図(b) および(c) はそれぞれ同図(a) および(b) における IB - IB 根および IC - IC 根での断面図である。

# 〔 発明の効果 〕 🧚

以上のように、この発明に係るマイクロ披回路

終において、その内部の半導体 女子の上に信号の 伝送方向と直交する方向にシールド板を設けたも のである。

#### (作用)

この発明におけるマイクロ波回路は、そのケース内部の半導体 累子の上に信号伝送方向と直交する方向にシールト板を設けたので、ケース内で発生する不要な導成管モートの伝搬を押えることができる。

### 〔発明の寒虅例〕

以下、この発明の第1の実施例を図について説明する。第1図(a) はこの実施例になるマイクロ故回路を伝送方向に切断した側面断面図、同図(b) は同図(a) の 1B - 1B 線における正面断面図であり、第2図は分解説明図である。

図において、(1)はマイクロストリップ綴路、(2) は半導体数子、(3)はケース、(5)はシールド板付カ パーである。

このような構成からなるマイクロ波回路では、 半海体表子(2)の上に、伝送万向と直交する方向に

では、そのケース内部の半導体象子の上に信号伝送方向と直交する方向にシールド板を設けたので、所要信号を損失なく伝搬し、かつ、不要な導放管モードによる伝搬を押えることができ、また、製作も容易なものが得られる効果がある。

# 4. 図面の簡単な説明

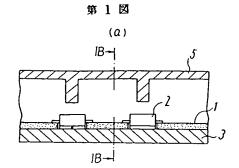
第1 図 la) はこの発明の第1 の実施例になるマイクロ波回路を伝送方向に切断した側面断面図、第1 図 lb) は同図 la) の l B - l B 線にかける正面断面図、第2 図 はその分解斜視説明図、第3 図 la) はこの発明の第2 の実施例になるマイクロ波回路を伝送方向に切断した側面断面図、第3 図 lb) は同図 lb) の ID C - ID C 線における平面断面図、第4 図 la) は従来マイクロ波回路を伝送方向に切断した断面図、第4 図 lb) はその N B - N B 線における正面断面図である。

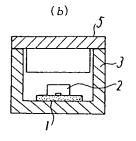
図において、(1)はマイクロストリップ般略、(2) は半導体君子、(3)はケース、(4)はカバー、(5)はシ ールド板つきカバー、(6)はシールド板である。

(6)

なか、以中同一符号は同一、または相当部分を示す。

代理人 早瀬 懲 ~



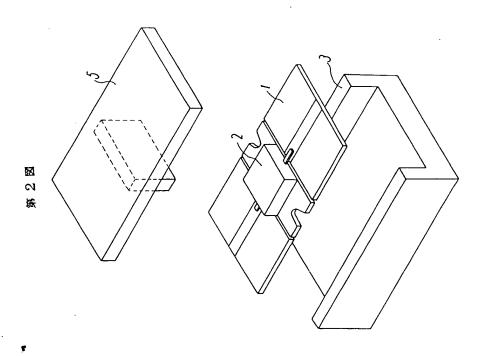


1:71クロストリップ線路

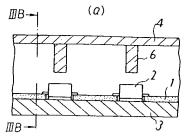
2: 半導体素子

J:ケース

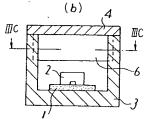
, 5:シールド板付カバー



第3図

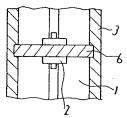


自動作計論 (原始



(c)

4:カバー 6:シールド板



第 4 図



